

产品特点:

K-5203 有机硅导热胶既有粘接作用, 又有良好的导热(散热)性。是一种经过补强的中性有机硅弹性胶, 胶固化后有良好的耐高低变化性能, 长期使用不会脱落, 不会产生接触缝隙降低散热效果; 因为有了补强, 该胶有较高的粘接强度, 剪切强度 ≥ 15 公斤/平方厘米。具有优异的耐高低温性能。它的使用温度范围为-60~280℃; 该胶是一种单组分室温固化胶, 用 100 毫升金属软管包装使用非常方便。

用途:

最主要的应用是代替导热硅脂(膏)作 CPU 与散热器、晶闸管智能控制模块与散热器、大功率电器模块与散热器之间的填充粘接。用此胶后可以除掉传统的用卡片和螺钉的连接方式, 带来的结果是更可靠的填充散热、更简单的工艺、更经济的成本。

技术性能:

		性能名称	测试值
固 化 前		颜色	白色
		粘度(cp)	触变糊状
		密度(g/cm ³)	2.0~2.5
		表干时间(25℃, min)	≤ 30
固 化 后	机 械 性 能	抗拉强度(MPa)	≥ 2.5
		扯断伸长率(%)	≥ 100
		剪切强度(MPa)	≥ 1.5
		硬度(shore A)	50~65
		使用温度范围(℃)	-60~280
	电 性 能	介电强度(kV/mm)	≥ 18
		介电常数(@60Hz)	2.8
		体积电阻($\Omega \cdot \text{cm}$)	1×10^{15}
		导热系数(w/(m.k))	1.2

使用方法:

- 1、将被粘或被涂覆物表面整理干净, 除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、拧开胶管盖帽, 将胶液挤到已清理干净的表面, 使之分布均匀将被粘面合拢固定即可。
- 3、将被粘好或密封好的部件置于空气中, 让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程, 在 24 小时以内(室温及 55%相对湿度)胶将固化 2-4mm 的深度, 如果部位位置较深, 尤其是在不容易接触到空气的部位, 完全固化的时间将会延长, 如果温度较低, 固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前, 建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。

注意事项: 操作完成后, 未用完的胶应立即拧紧盖帽, 密封保存。再次使用时, 若封口处有少许结皮, 将其去除即可, 不影响正常使用。

包装规格: 80g/支, 也可根据用户需要商定。

贮存: 贮存于阴凉干燥处, 25℃以下贮存期为一年。

说明: 以上数据是依据我们广泛实验所得, 结果是可靠的。但由于实际应用的多样性, 应用条件不是我们所能控制, 所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不承担特定条件下使用我公司产品出现的问题, 不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题, 可以和我公司技术服务部联系, 我们将竭力为您提供尽可能的帮助。